

3D-MC²B: 3D-Metalcore-LDS-Circuit-Board

3D-Leiterkartenaufbau mittels Polymerbeschichtungen von Metallsubstraten und Laser-Direkt-Strukturierung für kompakte leistungselektronische Applikationen

Förderkennzeichen: 13FH160PX8
Forschung an Fachhochschulen mit Unternehmen
FHprofUnt 2018
VDI Technologiezentrum



Projektlaufzeit: 08/2019 - 07/2022

Das Projekt befasst sich mit individuell gestaltbaren Schaltungsträgern und den daraus resultierenden Möglichkeiten, hochintegrierte Elektronik in komplexe und geringe Bauräume zu platzieren. Der innovative Ansatz ist die Verwendung pulverbeschichteter Metallgrundkörper, welche im Vergleich zu den bisherigen durch Spritzguss geformten Kunststoffen unter anderem erheblich bessere thermische Eigenschaften hinsichtlich Wärmemanagement aufweisen.